

INVESTOR RELATIONS

2022년 3분기

Your Most trustworthy



유의사항 [Disclaimer]

본 자료는 한국채택국제회계기준 연결실적에 대한 경영실적 및 재무성과를 바탕으로 작성되었습니다.

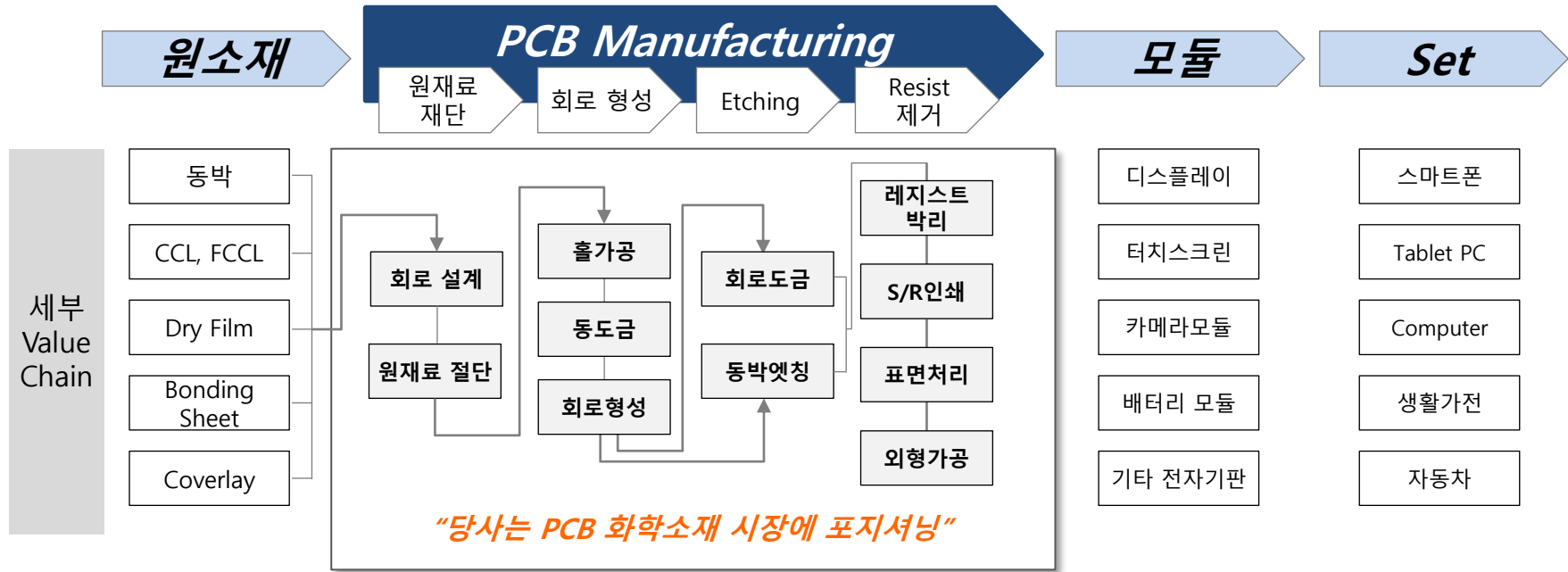
또한 본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있으며, 이러한 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 불확실성으로 인하여, 실제 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

- 국내외 국가정책변경에 따른 세율 변동 (FTA, 관세, 법인세 등)
- 환율 및 이자 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향
- 주요 매출시장의 환경의 예상치 못한 급격한 변화
- 회사내의 전략적인 의사결정

이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과는 중대한 차이가 있을 수 있습니다.



PCB Industry value chain



당사의 주요 포지셔닝은 PCB 화학소재이며 특히 부가가치가 높은 최종표면처리 및 화학동도금 Segment에서 주요 매출이 발생되고 있습니다.

주요고객사 (Major Customer)

“주로 한국, 중국, 대만의 FPCB 회사들이 주요 고객사이며, 최근 한국의 PKG Substrate 제조사로 고객사 확대 중”
 End User 또한 기존 스마트폰 제조사에 한정되어 있었으나 전기차, 통신칩 등 첨단 산업으로 확대

FPCB Customer	   
	   
	   
PKG Substrate	    

Total Solution for Customer

와이엠티는 공정의 첫 단계인 세정/박리제부터 최종표면처리까지, 모든 화학소재 기술을 보유함으로써 고객사 설비 특성에 맞는 Total chemical solution을 제공하고 있습니다.



Final Finishing Chemical

Soft ENIG Process

- ✓ CF 300 Series
- ✓ MIKO Series

ENIG Process

- ✓ PEN Series
- ✓ MIKO Series

ENEPIG Process

- ✓ PEN Series
- ✓ ELP or ZEP Series
- ✓ IR Gold Series

EPIG process

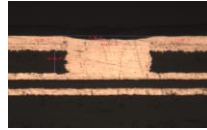
- ✓ ZEP Series
- ✓ IR Gold Series

Immersion process

- ✓ PROTIN Series

Electrolytic gold process

- ✓ HG 300 series
- ✓ SAU 10 series



Copper plating chemical

Electroless Copper plating

- ✓ HVF Series
- ✓ MJH series

Electrolytic Copper plating

- ✓ BJ series
- ✓ HBJ Series(Half-fill)
- ✓ FSBJ Series(flash plating)
- ✓ ZEUS Series(Via-fill)



Process Chemical

DES Chemical

- ✓ MSAP/SAP DFR Stripper
- ✓ MSAP/SAP Cu seed Etchant
- ✓ GMZ Series
- ✓ HWA Series

Cleaner

- ✓ FXC Series
- ✓ EQ Series

Gold Recover

UBM Etchant

LAZ Process



New product for 5G

No etching and roughness laminating pretreatment

Ultra low profile detachable thin copper foil

Positive Cu roughening

Process Nanotus®

Electroless Copper plating for LCP

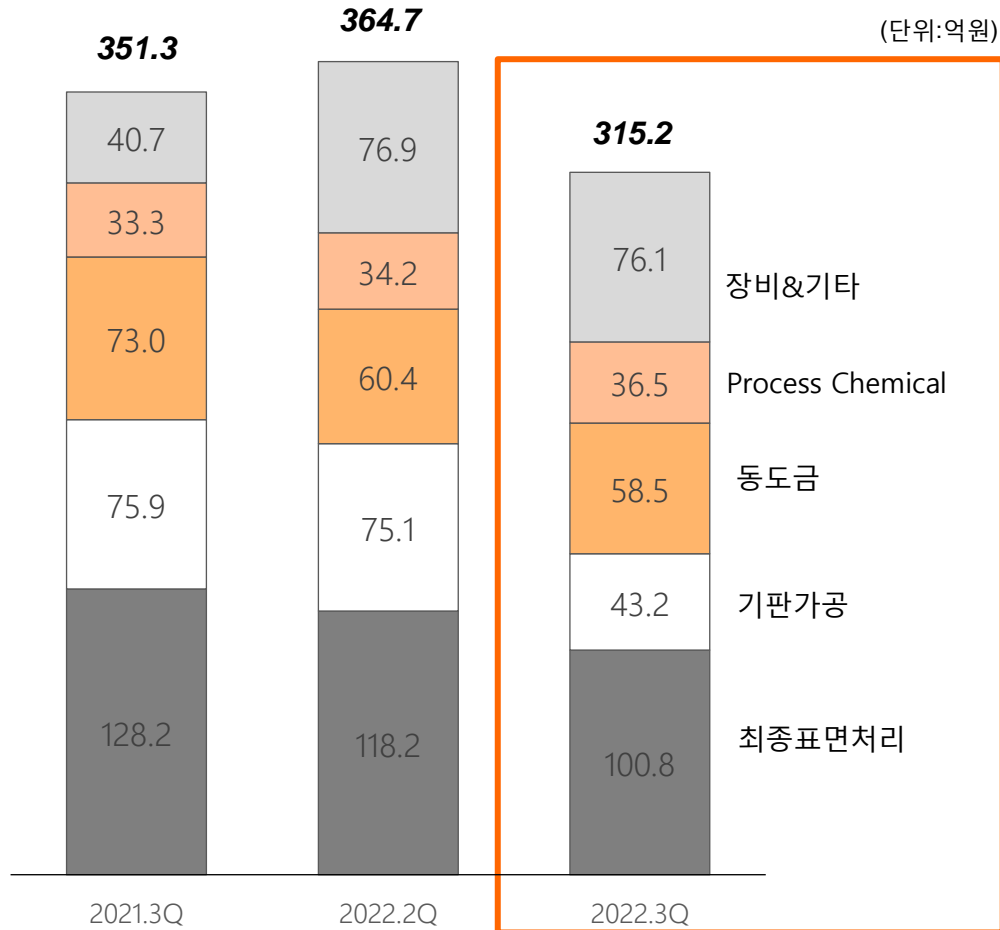
Domestic Market situation

신규 사업분야
기존 사업분야

		"기존 사업영역"		"22년 신규진입분야"					
		FPCB, RFPCB		PKG		HDI		RIGID	
Major player	Domestic	<ul style="list-style-type: none"> SEMCO BH Flex Youngpoong Daeduck 		<ul style="list-style-type: none"> SEMCO Daeduck SIMTECH Korea Circuit 		<ul style="list-style-type: none"> Daeduck LG Innoteck Korea Circuit 		<ul style="list-style-type: none"> Hyunwoo SEIL 	
	Global	<ul style="list-style-type: none"> Zhending Technology Career Unimicron Mektron 		<ul style="list-style-type: none"> AT&S Zhending Technology Ibiden 		<ul style="list-style-type: none"> AT&S Zhending Technology Ibiden 		<ul style="list-style-type: none"> Various 	
Process Chemical		<ul style="list-style-type: none"> 점유율 확대 중 Fine pattern 용 고부가가치 박리액 등 프로모션 		<ul style="list-style-type: none"> 고객사 라인 확대중 		<ul style="list-style-type: none"> - 		<ul style="list-style-type: none"> - 	
Cu Plating	Electroless	<ul style="list-style-type: none"> 국내 높은 수준의 점유율 보유 (40% 이상 추정) 		<ul style="list-style-type: none"> PKG 고객사 증설에 따라 매출 확대 전망 신규 고객사 확대 		<ul style="list-style-type: none"> - 		<ul style="list-style-type: none"> - 	
	Electro	<ul style="list-style-type: none"> 외주를 통한 양산 		<ul style="list-style-type: none"> 현재 자회사 외주를 통한 매출발생 중 		<ul style="list-style-type: none"> Developing 		<ul style="list-style-type: none"> - 	
최종표면처리	Electroless	<ul style="list-style-type: none"> 금도금 분야 전세계 1위 점유율 확보 (50%이상) 		<ul style="list-style-type: none"> 고객사 평가 중 		<ul style="list-style-type: none"> Developing 		<ul style="list-style-type: none"> 일부 국내 고객사 거래 중 	
	Electro	<ul style="list-style-type: none"> 베트남 시장 전해금도금 외주물량 확대 		<ul style="list-style-type: none"> Developing 		<ul style="list-style-type: none"> Developing 		<ul style="list-style-type: none"> Developing 	

Sales Result

■ 최종표면처리 □ 기판가공 ■ 동도금 ■ Process Chemical □ 기타 및 장비



• 3분기 스마트폰 생산차질로 인한 매출 감소

- ✓ 북미 스마트폰 제조사 매출 발생으로 전년 동기 대비 실적 감소
- ✓ 경기 둔화로 인한 수요량 감소, 반도체 공급부족, 중국 내 코로나 바이러스 확대로 인한 생산차질 등의 원인으로 화학약품 소모량 감소
- ✓ 한국과 베트남 모두 기판가공 사업부 매출 하락 (전장 쪽 매출은 증가하였으나 스마트폰향 외주물량 감소)
- ✓ 중국법인 : 21년 3분기 81.5억원 대비 19억 감소
- ✓ 베트남법인 : 21년 3분기 103억 대비 24억 감소

• 신규사업(동박)의 양산 시작

- ✓ 22년 11월 현재 양산을 시작하였으며 내년도 매출 확대 전망
- ✓ 단, 아직은 매출 규모가 적기 때문에 이익개선 효과는 크지 않음

• 살균원단(마스크)사업의 BEP 도달

- ✓ 현재 일 평균 매출 약 1,500만원으로 매출이 꾸준한 증가세를 보임

신규사업 진행현황

소재사업 (동박)

- 국내 PKG Substrate 고객사의 제품 向 양산을 개시하였으며, 점진적으로 가동률은 증가할 것
- 두께가 매우 얇은 극동박으로 5G 통신칩 기판 제조공정에 적용중임. 향후 적용처 또한 확대될 것
- 동박의 표면 두께의 높이 편차(‘조도’)가 매우 작은 저조도 동박으로 전송손실과 밀착력 측면에서 기존 제품대비 매우 우수한 성능
- 현재 매출 Capa. 연간 200억원 수준으로 내년도 1000억원 이상의 양산이 가능한 공장 확보를 목표로 규모로 신규투자예정

마스크

- 하반기 일매출 1300만원 이상으로 BEP 포인트에 도달
- 매출에 연동되는 광고선전비 집행으로 향후에도 자체적인 자금으로 사업 운영가능
- 바이오(특수봉대) 분야로 현재 임상중

Metal Encap

- 당사는 니켈을 활용하여 invar 대체가능한 제품을 개발완료 하였으며 현재 사업부와 함께 양산을 타겟으로 한 개발중

Income Statement

(단위:억원)

	2022.3Q	매출비중	2021.3Q	매출비중
I. 매출액	987.1	100%	928.4	100%
II. 매출원가	743.5	75.3%	647.1	69.7%
III. 매출총이익	243.6	24.7%	281.3	30.3%
판매비와 관리비	199.5	20.2%	124.5	13.4%
IV. 영업이익	44.1	4.5%	156.8	16.9%
금융수익	104.2	10.6%	50.3	5.4%
금융비용	50.8	5.1%	48.0	5.2%
기타수익	5.0	0.5%	5.0	0.5%
기타비용	7.4	0.8%	2.8	0.3%
지분법손익	-	-	-	-
V. 법인세차감전순이익	95.1	9.6%	161.3	17.4%
법인세비용	20.6	2.1%	31.8	3.4%
VI. 당기순이익	74.5	7.6%	129.5	14.0%

주요 수익성 지표

	2022.3Q	2021.3Q
영업이익률	4.5%	16.9%
순이익률	7.6%	14.0%
EBIT	103.1	207.0
EBITDA (마진율)	10.44%	22.30%
ROE	4.2%	8.6%
총자산회전률	39.2%	44.0%

- ✓ 원자재 가격 상승으로 인한 영업 이익감소, 코로나 및 반도체 공급부족으로 인한 시장 물량 감소, 이로 인한 매출 하락이 실적 악화의 원인
- ✓ 동박 사업의 사양산 비용 반영
- ✓ 전환사채조기상환권 평가이익 및 외화환산평가이익 증가로 인한 금융수익 증가

Balance Sheet

(단위:억원)

	2022.3Q	2021
자산		
현금성자산	521.5	701.9
매출채권	229.6	260.9
재고자산	212.1	190.5
유형자산	1,149.1	955.3
기타자산	456.0	354.0
자산총계	2,568.3	2,462.6
부채		
매입채무	25.1	36.9
차입금	686.4	682.5
전환사채	0.0	95.2
기타부채	230.4	254.4
부채총계	941.9	1,069.0
자본		
자본금	81.6	74.8
자본잉여금	364.0	249.4
기타자본	84.8	38.9
이익잉여금	812.0	768.9
비지배지분	284.0	261.6
자본총계	1,626.4	1,393.6
부채와 자본총계	2,568.3	2,462.6

Cash Flow

(단위:억원)

	2022.3Q	2021.3Q
기초현금	701.9	556.4
영업활동으로 인한 현금흐름	122.2	145.8
당기순이익	74.5	129.6
감가상각비	51.2	41.7
외화환산이익	(54.7)	(27.8)
기타	51.2	2.3
투자활동으로 인한 현금흐름	(339.8)	(184.8)
유형자산의 처분(취득)	(215.5)	(164.7)
금융상품의 감소(증가)	(143.5)	(18.1)
기타	19.2	(2.0)
재무활동으로 인한 현금흐름	(3.4)	8.7
차입금의 증가(감소)	3.9	48.9
전환사채의 상환	0.0	(40.0)
기타	(7.3)	(0.2)
현금증감	(221.0)	(30.3)
환율 변동효과	40.6	39.3
기말현금	521.5	565.4